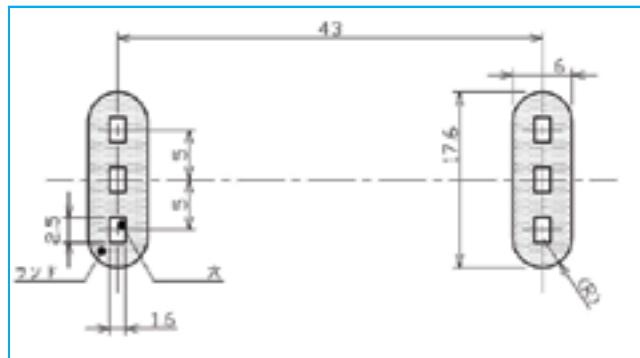


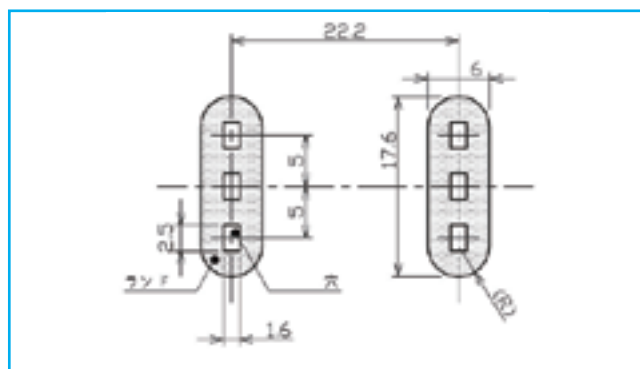
GHKシリーズヒューズ基板取付設計資料

1. 推奨取付穴ピッチ・推奨ランド

●750GHKシリーズ



●350GHKシリーズ



2. 沿面距離、空間距離

ヒューズ遮断時においては両端子間に大きな電圧が加わります。
ランド間距離、他の部品との距離の推奨値を下表に示します。

シリーズ	両端子ランド間距離		ヒューズと部品の距離
	コーティングされた基板	コーティングなしの基板	
350GHK	3mm以上	5mm以上	4mm以上
750GHK	5mm以上	8mm以上	6mm以上

3. ヒューズ温度上昇

ヒューズの温度は、基板のパターン、通電電流等により変わります。
弊社の基板用ヒューズの温度上昇特性は、定格電流の50%の電流に対して1A/mm(35μm銅箔厚)となる銅箔幅によるものです。
例：100A定格品の場合、50mm銅箔幅のパターンでの試験となります。

●試験基板

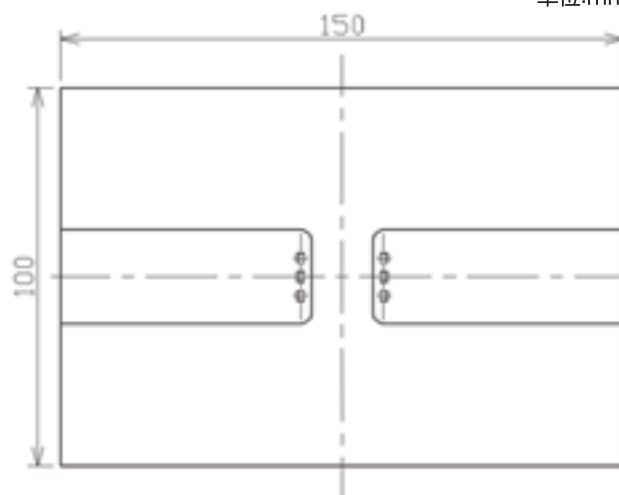
基板サイズ：150mm×100mm

基板材質：FR-4

銅箔厚：35μm

銅箔幅：定格電流により異なる

単位:mm



基板実装ヒューズ フローソルダー法温度プロファイル

